

委托说明

根据项目任务要求,传感芯片在智能物联网应用场景下面临的能量效率、数据通信带宽受限等性能瓶颈和技术难题,本项目提出应用于智能物联网节点的基于三维堆叠工艺的新型图像数据感存算融合系统架构,通过系统和芯片架构的协同优化,提高整体能效。为达到这一指标,选择 0.18um CMOS MIXED SIGNAL 工艺下进行多项目晶圆(MPW)流片,该工艺的速度、功耗能够满足项目任务书中的相应指标要求。在进行了深入的调研并与多家公司进行咨询后,TSMC 0.18um CMOS MIXED SIGNAL RF 1P6M+AL SALICIDE 1.8/3.3V 工艺在价格和性能上都表现出色。然而,能够提供这项技术服务并确保在规定时间内完成的公司并不多见。为了确保流片工作的顺利进行,我们联系并评估了多家技术服务公司,包括上海纳诺芯微电子科技有限公司、合肥市微电子研究院有限公司和苏州苏韵微电子有限公司。经核查比较,上海纳诺芯微电子科技有限公司符合本次技术服务需求,并且收费合理,故拟委托上海纳诺芯微电子科技有限公司在台积电进行该项目的 MPW 流片。

项目负责人:

日期:

